

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、公司经营情况介绍

公司2025年第二季度实现营业收入184,625.97万元，环比增长16.88%；归属于上市公司股东的净利润1,946.05万元，环比增长107.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,983.94万元，环比增长477.39%。

2025年上半年，公司实现营业收入342,586.34万元、同比增长18.91%；归属于上市公司股东的净利润2,883.29万元、同比增长47.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,673.94万元、同比增长62.50%。总资产1,498,980.85万元、较上年末增长9.67%；归属于上市公司股东的净资产505,018.69万元、较上年末增长2.32%。

报告期内，公司整体毛利率为18.45%，同比增长1.89个百分点；受益于行业复苏，公司营业收入保持稳定增长；净利润虽维持增长，但仍受FCBGA封装基板项目和宜兴硅谷高多层PCB业务的亏损拖累，其中，FCBGA封装基板项目整体费用投入32,978.05万元，宜兴硅谷因客户和产品结构不佳、以及竞争激烈导致产能未能充分释放，亏损8,210.24万元。

二、行业情况分析

2025年以来，全球PCB行业仍延续结构分化的复苏态势，AI产业仍为主要驱动力。根据Prismark报告，预计2025年全球PCB行业的产值为791.28亿美元、同比增长7.6%，相较原先6.8%的增长预期小幅上调，主要是整个行业的复苏状况比之前的预期要更好。从产品结构看，表现最佳的还是18层及以上PCB板和HDI板两大赛道，预期2025年增长率分别为41.7%、12.9%；封装基板将持续复苏，增长率为7.6%；常规多层板因整体市场需求好转及订单价格有所恢复，市场格局有所好转。从区域市场看，中国和东南亚的市场表现会比全球其他区域更好一些。中国市场主要是因高多层板和HDI的技术优势及把握了AI行业爆发带来的机会，东南亚市场则受益于产业链转移的趋势。从下游来看，AI、网通、卫星通信仍然是增长最快的几个细分领域，对高多层高速板和HDI板的需求拉动还会持续。2025年封装基板行业的表现会比2024年好，2026年有望持续好转。从目前情况来看，BT载板的表现更好、ABF载板行业在逐步回暖，主要还是受AI的拉动，叠加存储芯片的复苏、消费电子的回暖提供了基础支撑。海外部分同行今年7月的产值都创了2023年1月以来的新高，营收

同比增速加快，从海外同行对整个载板行业的预期来看，后市相对乐观，主要挑战还是集中在半导体限制政策。我们判断PCB行业调整周期已经结束，整体复苏态势有望持续，行业内卷格局也在逐步缓和，未来前景是相对看好的。

三、FCBGA封装基板项目的进展情况

截至目前，公司FCBGA封装基板项目的整体投资规模已超38亿，公司已在技术能力、产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备，且整体良率持续改善，为后续的量产奠定坚实基础。2025年上半年样品订单数量已超过2024年全年，且样品订单中高层数和大尺寸产品的比例在持续提升，样品持续交付认证中，为可能的量产机会奠定基础。同时，在全力拓展国内客户的基础之上，公司持续攻坚海外客户，努力争取后续的审厂、打样和量产机会。

四、CSP封装基板业务介绍

CSP封装基板业务聚焦于存储、射频两大主力方向，并向汽车市场拓展，产品结构逐步向高附加值高单价的方向拓展，尤其是多层板难度板，致力于通过优化产品结构增强盈利能力。

受益于存储芯片行业复苏和主要客户的份额提升，公司CSP封装基板业务产能利用率逐季提升，整体收入实现较快增长。其中，广州科技和珠海兴科原有3.5万平方米/月产能已实现满产，珠海兴科新扩产能（1.5万平方米/月）已于今年7月份投产、并开始释放产能。因行业回暖、叠加大宗原材料价格上涨，CSP封装基板产品价格也有所上涨，整体盈利能力有所提升。

五、公司传统PCB业务介绍

报告期内，公司PCB业务实现收入244,785.93万元、同比增长12.80%，毛利率26.32%、同比略降0.77个百分点。

总体而言，公司PCB样板业务维持稳定增长。北京兴斐HDI板和类载板（SLP）业务持续增长；宜兴硅谷高多层PCB量产业务表现落后于行业主要友商，第三季度随着其产品价格逐步提升，及更严格的成本管控，其下半年经营绩效相对于上半年有望改善，公司将持续优化生产工艺、提升自身良率水平和交付能力，调整客户和产品结构，并加大力度拓展海外市场，争取进一步减少亏损。

	<p>六、北京兴斐电子有限公司情况介绍</p> <p>北京兴斐表现持续超预期，受益于战略客户高端手机业务的持续增长、份额提升及高端光模块基板批量出货，实现收入49,953.28万元、同比增长25.50%，净利润8,556.44万元，同比增长46.86%。目前，北京兴斐正规划进一步扩充面向AI领域的高阶HDI产能，以把握AI爆发带来的行业机会。</p> <p>七、公司新的研发方向和技术储备</p> <p>公司新产品和新技术的研发方向聚焦于多种材料与不同工艺融合的结构复杂、多功能化的产品，包括埋入式基板（比如内埋器件PCB、内埋器件HDI等）、超大尺寸ABF载板、玻璃基板、磁性基板、卫星通信PCB以及高厚径比镀铜能力、精细路线产品等。</p> <p>在摩尔定律放缓的时候，封装工艺暂时也不会有大的突破，那未来主要的创新就集中在线路板技术的创新和突破，整个线路板的结构会变得越来越复杂，功能会变得越来越强化，价值量也会越来越大。公司不断精进自身在线路板行业前沿的工艺水平和产品能力，以增强市场竞争力。未来的工作重心是加强市场拓展能力，提升新产品和新技术的量产能力，在满足客户需求的同时，实现公司营收规模和利润规模的提升。</p>
附件清单	无
日期	2025年8月27日